



nano SIM



Push / Push



Ultra Low Profile

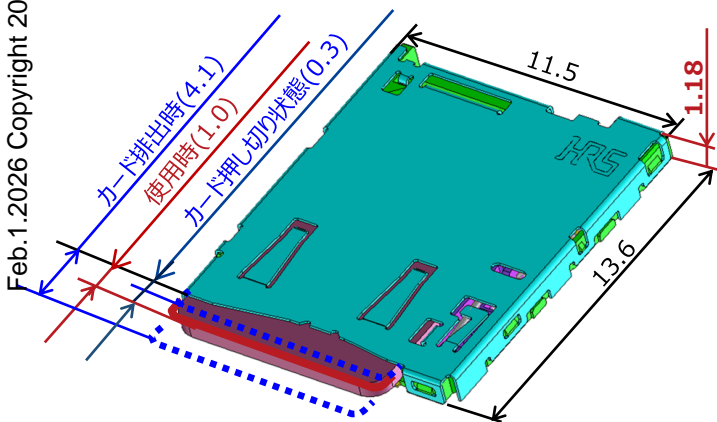
特長

- 1 高さ1.18mmの省スペース設計
- 2 カード逆挿し防止
- 3 カード飛び出し防止設計
- 4 カード検出スイッチ付き
- 5 基板実装状態の目視検査が可能

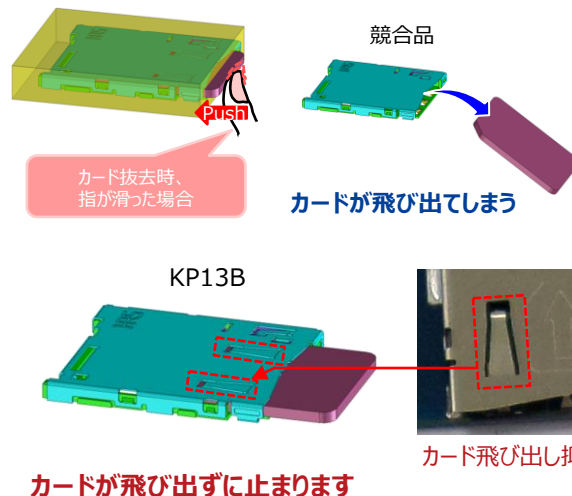


*2017年2月現在

寸法



カード飛び出し防止



特性

接触抵抗	100mΩ 以下
耐電圧	AC 500Vで1分間追加
絶縁抵抗	1000MΩ 以上 (DC 500V)
定格電流	0.5A
定格電圧	AC 10V
使用温度範囲	-30℃~+85℃
挿抜回数	5,000回

・ RoHS、ハロゲンフリー対応*

* 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
(Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、
Br+Cl 総含有率：1500ppm以下)

※ 車載機器向けに採用ご検討の際は、担当営業までご相談下さい。



nano SIM



Push / Pull



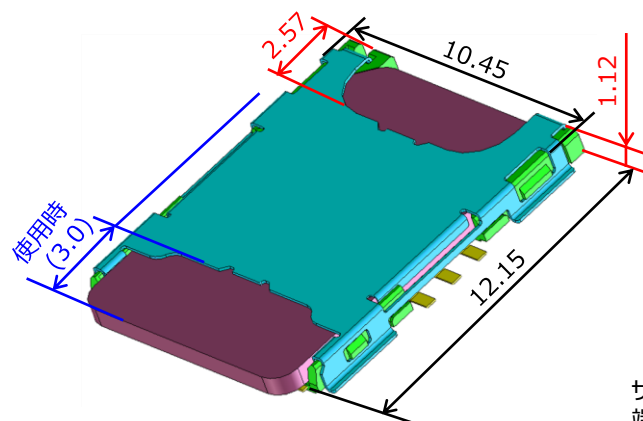
Low Profile



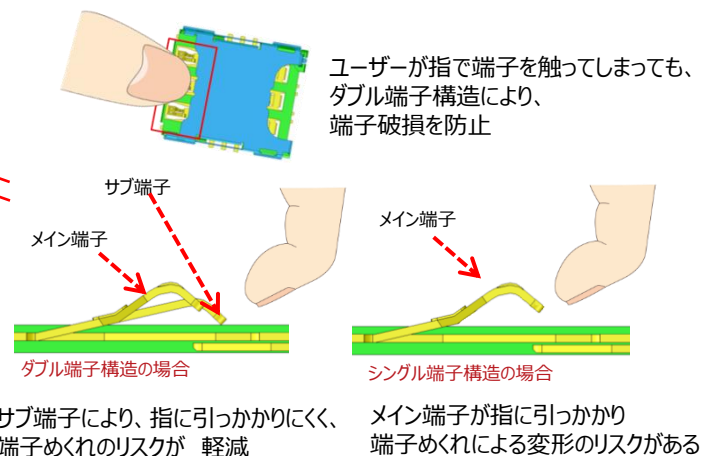
特長

- 1 高さ1.12mmの省スペース設計
- 2 ソケット後部からカードを押し出せる設計
- 3 カード誤挿入防止構造
- 4 端子破損防止
- 5 検査やリワークが容易なアウターリード設計

寸法



端子破損防止



特性

接触抵抗	100mΩ 以下
耐電圧	AC 500Vで1分間印加
絶縁抵抗	1000MΩ 以上 (DC 500V)
定格電流	0.5A
定格電圧	AC 10V
使用温度範囲	-30℃~+85℃
挿抜回数	5,000回

・ RoHS、ハロゲンフリー対応*

* 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
(Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、
Br+Cl 総含有率：1500ppm以下)

※ 車載機器向けに採用ご検討の際は、担当営業までご相談下さい。



nano SIM



Push / Pull



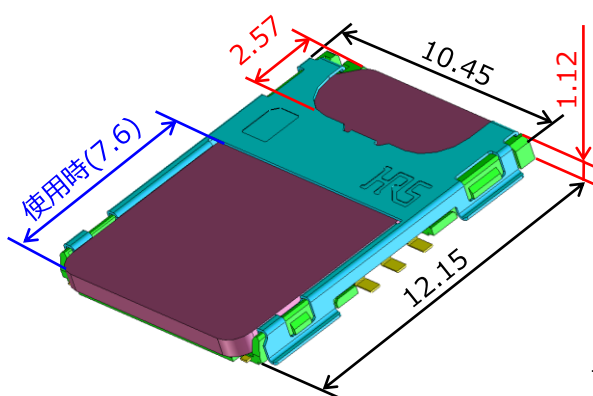
Low Profile



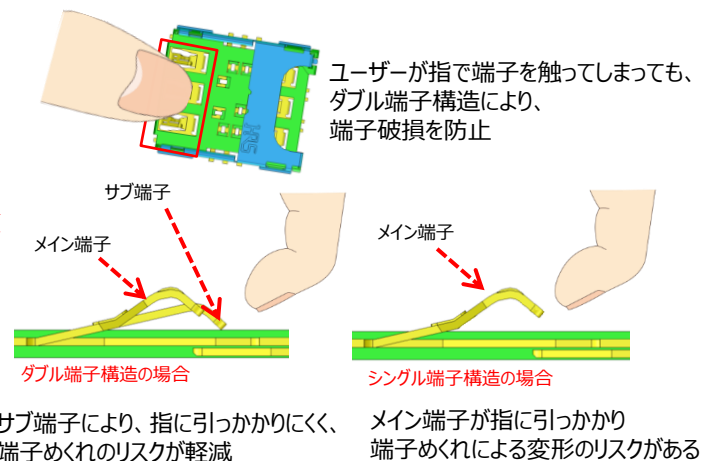
特長

- 1 高さ1.12mmの省スペース設計
- 2 ソケット後部からカードを押し出せる設計
- 3 カード誤挿入防止構造
- 4 端子破損防止
- 5 検査やリワークが容易なアウターリード設計

寸法



端子破損防止



仕様

接触抵抗	100mΩ 以下
耐電圧	AC 500Vで1分間印加
絶縁抵抗	1000MΩ 以上 (DC 500V)
定格電流	0.5A
定格電圧	AC 10V
使用温度範囲	-30℃~+85℃
挿抜回数	5,000回

・ RoHS、ハロゲンフリー対応*

* 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
(Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、
Br+Cl 総含有率：1500ppm以下)

※ 車載機器向けに採用ご検討の際は、担当営業までご相談下さい。



nano SIM



Tray



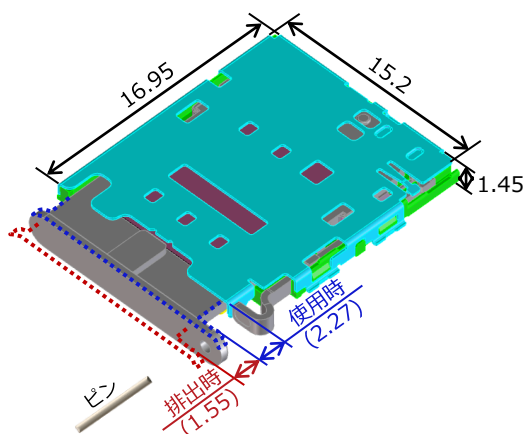
Low Profile



特長

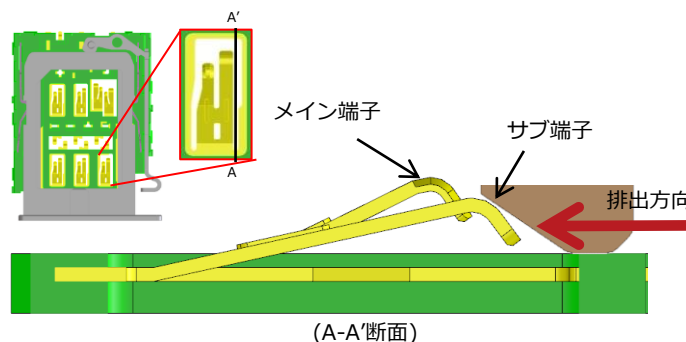
- 1 ピンでトレイを排出するピンジェクトタイプにより良好な操作性を実現
- 2 座屈防止構造により、トレイ挿抜時の引っ掛かりによる端子変形を防止
- 3 ラッチ構造により優れた接触信頼性
- 4 カード検出スイッチ付き
- 5 基板実装状態の目視検査が可能

寸法



※トレイは本製品に含まれておりません。
お客様にてご用意ください。

座屈防止構造



メイン端子よりサブ端子を長く設計することにより
サブ端子がトレイと先に接触し、サブ端子を連動して
メイン端子もスムーズに下がり、座屈を防止します。

特性

接触抵抗	100mΩ 以下
耐電圧	AC 500Vで1分間印加
絶縁抵抗	1,000MΩ 以上. (DC 500V)
定格電流	0.5A
定格電圧	AC 10V
使用温度範囲	-30℃ ~ +85℃
挿抜回数	3,000 回

・ RoHS、ハロゲンフリー対応*

* 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
(Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、
Br+Cl 総含有率：1500ppm以下)

※ 車載機器向けに採用ご検討の際は、担当営業までご相談下さい。